

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二二年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2023年2月14日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二二年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二二年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入達 6.301 億美元，同比上升 19.3%，環比持平。
- 毛利率上升至 38.2%，同比上升 5.7 個百分點，環比上升 1.0 個百分點。
- 期內溢利 1.858 億美元，同比上升 35.4%，環比上升 183.9%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.591 億美元，同比上升 19.2%，環比上升 53.2%。
- 基本每股盈利 0.122 美元，同比上升 18.4%，環比上升 52.5%。
- 淨資產收益率（年化）22.0%，同比上升 2.8 個百分點，環比上升 7.6 個百分點。

二零二三年第一季度指引

- 我們預計銷售收入約 6.30 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 32%至 34%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對第四季度業績評論道：

“儘管疫情影響、地緣衝突等極端、多元的不確定因素為半導體行業帶來前所未有的挑戰，華虹半導體在 2022 年第四季度仍保持穩中有升，銷售收入達到 6.301 億美元，連續十個季度刷新紀錄，同比增長 19.3%；也使得 2022 年全年銷售收入達到了 24.76 億美元，較 2021 年增長了 51.8%。同時，公司一直以來深耕多元化特色工藝，持續技術升級和產能擴張，以及時滿足市場新需求。在保證各個工廠產能利用率前提下，不斷優化產品及業務組合，以此獲得合理的銷售價格提升，使得第四季度毛利率提升到 38.2%，同比增加 5.7 個百分點；2022 年全年毛利率達到 34.1%，較 2021 年增加 6.4 個百分點。淨資產收益率也大幅提高，第四季度年化收益率達到了 22%，全年收益率也達到了 15.2%，較 2021 年全年收益率增加 5.5 個百分點。為 2022 年書寫了出色、亮麗的業績。在此，我衷心感謝全體員工和合作夥伴為此付出的不懈努力。”

唐總繼續講道：“展望 2023 年，我們將繼續強化在各個特色工藝領域的優勢，緊跟市場趨勢動態調整營銷策略，以更豐富、更具有競爭力的工藝方案來更好地滿足國內外客戶的需求。產能方面，將保持 8 英寸平臺持續優化、12 英寸平臺技術升級及產能擴張的策略。12 英寸第一階段擴產已全面完成，2022 年全年以 6.5 萬片月產能運行；第二階段擴產設備已全部到位，2023 年內將陸續釋放月產能至 9.5 萬片；同時將適時啟動新廠建設，計畫把差異化特色工藝向更先進節點推進。行到半山不止步，中流擊水當奮楫，新年芯機遇，華虹半導體準備充分、信心十足！”

電話會議公告

- 日期 2023 年 2 月 14 日（星期二）
- 時間： 16:00 香港/上海時間
03:00 美國東部時間
- 發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官
- 廣播： 會議將在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/ga4sbj3u> 作線上直播。
(請提前註冊登記)
- 電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及個人 PIN。
<https://register.vevent.com/register/Blfc77b44b2d874ff09c35c90724dac668>
重要提示： 在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的個人 PIN 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN。
- 網上重播： 直播約 12 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，專注於非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等「8 英寸 + 12 英寸」特色工藝技術的持續創新，先進「特色 IC + Power Discrete」強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有「8 英寸 + 12 英寸」生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片。同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 6.5 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），是國內領先的 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	630,110	528,317	629,907	19.3 %	0.0 %
毛利	240,707	171,517	234,056	40.3 %	2.8 %
毛利率	38.2 %	32.5 %	37.2 %	5.7	1.0
經營開支	(59,579)	(31,866)	(73,611)	87.0 %	(19.1)%
其他收入/(損失)淨額	35,565	27,812	(57,825)	27.9 %	(161.5)%
稅前溢利	216,693	167,463	102,620	29.4 %	111.2 %
所得稅開支	(30,918)	(30,213)	(37,174)	2.3 %	(16.8)%
期內溢利	185,775	137,250	65,446	35.4 %	183.9 %
淨利潤率	29.5 %	26.0 %	10.4 %	3.5	19.1
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	159,136	133,528	103,899	19.2 %	53.2 %
非控股權益	26,639	3,722	(38,453)	615.7 %	(169.3)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.122	0.103	0.080	18.4 %	52.5 %
攤薄	0.121	0.101	0.079	19.8 %	53.2 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	992	1,022	1,003	(2.9)%	(1.1)%
產能利用率 ¹	103.2 %	105.4 %	110.8 %	(2.2)	(7.6)
淨資產收益率 ²	22.0 %	19.2 %	14.4 %	2.8	7.6

二零二二年第四季度

- 銷售收入達 6.301 億美元，同比上升 19.3%，環比持平。
- 毛利率上升至 38.2%，同比上升 5.7 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲，部分被折舊成本上升所抵消，環比上升 1.0 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲。
- 經營開支 5,960 萬美元，同比上升 87.0%，主要由於研發活動的政府補助減少，環比下降 19.1%，主要由於研發活動的政府補助增加。
- 其他收入淨額 3,560 萬美元，同比上升 27.9%，主要由於利息收入及分佔聯營公司溢利增加，部分被財務費用增加所抵消。上季度為其他損失淨額 5,780 萬美元，主要由於發生較大外幣匯兌損失。
- 所得稅開支 3,090 萬美元，同比上升 2.3%。
- 期內溢利 1.858 億美元，同比上升 35.4%，環比上升 183.9%。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.591 億美元，同比上升 19.2%，環比上升 53.2%。
- 基本每股盈利 0.122 美元，同比上升 18.4%，環比上升 52.5%。
- 淨資產收益率(年化) 22.0%，同比上升 2.8 個百分點，環比上升 7.6 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	2022 (未經審核)	2021 (已審核)	同比
銷售收入	2,475,488	1,630,754	51.8 %
毛利	843,656	451,598	86.8 %
毛利率	34.1 %	27.7 %	6.4
經營開支	(279,130)	(209,593)	33.2 %
其他(損失)/收入淨額	(68,456)	54,315	(226.0)%
稅前溢利	496,070	296,320	67.4 %
所得稅開支	(89,499)	(65,349)	37.0 %
年內溢利	406,571	230,971	76.0 %
淨利潤率	16.4 %	14.2 %	2.2
以下各方應佔利潤：			
母公司擁有人	449,912	261,476	72.1 %
非控股權益	(43,341)	(30,505)	42.1 %
持有人應佔每股盈利			
基本	0.345	0.201	71.6 %
攤薄	0.342	0.198	72.7 %
付運晶圓(折合 8 吋矽片)	4,088	3,328	22.8 %
產能利用率³	107.4 %	107.5 %	(0.1)
淨資產收益率⁴	15.2 %	9.7 %	5.5

二零二二年度

- 銷售收入創歷史新高，達 24.755 億美元，較上年度增長 51.8%。
- 毛利率 34.1%，較上年度上升 6.4 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲及產品組合優化，部分被折舊成本上升所抵消。
- 經營開支 2.791 億美元，較上年度上升 33.2%，主要由於研發活動的政府補助減少及人員開支上升。
- 其他損失淨額 6,850 萬美元，上年度為其他收入淨額 5,430 萬美元，主要由於本年發生外幣匯兌損失，而上年為外幣匯兌收益。
- 年內溢利 4.066 億美元，較上年度上升 76.0%。
- 母公司擁有人應佔溢利 4.499 億美元，較上年度上升 72.1%。
- 基本每股盈利 0.345 美元，較上年度上升 71.6%。
- 淨資產收益率 15.2%，較上年度上升 5.5 個百分點。

³產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

⁴母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	二零二一年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	602,591	95.6 %	507,184	96.0 %	95,406	18.8 %
其他	27,519	4.4 %	21,133	4.0 %	6,387	30.2 %
銷售收入總額	630,110	100.0 %	528,317	100.0 %	101,793	19.3 %

- 本季度 95.6% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	二零二一年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	397,513	63.1 %	322,631	61.1 %	74,882	23.2 %
12 吋晶圓	232,597	36.9 %	205,686	38.9 %	26,911	13.1 %
銷售收入總額	630,110	100.0 %	528,317	100.0 %	101,793	19.3 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 3.975 億美元及 2.326 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	二零二一年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ⁵	456,876	72.6 %	398,900	75.5 %	57,976	14.5 %
北美 ⁶	85,956	13.6 %	53,520	10.1 %	32,436	60.6 %
亞洲 ⁷	42,055	6.7 %	50,505	9.6 %	(8,450)	(16.7)%
歐洲	33,690	5.3 %	18,612	3.5 %	15,078	81.0 %
日本 ⁸	11,533	1.8 %	6,780	1.3 %	4,753	70.1 %
銷售收入總額	630,110	100.0 %	528,317	100.0 %	101,793	19.3 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.569 億美元，占銷售收入總額的 72.6%，同比增長 14.5%，主要得益於 MCU、IGBT、超級結及智能卡芯片的需求增加，部分被邏輯產品需求下降所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 8,600 萬美元，同比增長 60.6%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 4,210 萬美元，同比下降 16.7%，主要由於分立器件及邏輯產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 3,370 萬美元，同比增長 81.0%，主要得益於智能卡芯片、通用 MOSFET 及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 1,150 萬美元，同比增長 70.1%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。

⁵包括中國大陸及中國香港。

⁶包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁷不包括中國及日本。

⁸包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	仟美元	%
嵌入式非易失性存儲器	236,281	37.5 %	134,508	25.5 %	101,773	75.7 %
獨立式非易失性存儲器	36,557	5.8 %	39,013	7.4 %	(2,456)	(6.3)%
分立器件	212,972	33.8 %	175,512	33.2 %	37,460	21.3 %
邏輯及射頻	42,942	6.8 %	85,114	16.1 %	(42,172)	(49.5)%
模擬與電源管理	100,940	16.0 %	93,640	17.7 %	7,300	7.8 %
其他	418	0.1 %	530	0.1 %	(112)	(21.1)%
銷售收入總額	630,110	100.0 %	528,317	100.0 %	101,793	19.3 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 2.363 億美元，同比增長 75.7%，主要得益於 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 3,660 萬美元，同比下降 6.3%，主要由於 NOR flash 產品的需求減少。
- 本季度分立器件銷售收入 2.130 億美元，同比增長 21.3%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 4,290 萬美元，同比下降 49.5%，主要由於 CIS 及邏輯產品的需求減少。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.009 億美元，同比增長 7.8%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二二年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二二年 第四季度 % (未經審核)	二零二一年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	59,244	9.4 %	74,490	14.1 %	(15,246)	(20.5)%
90nm 及 95nm	124,450	19.8 %	103,522	19.6 %	20,928	20.2 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	126,128	20.0 %	84,414	16.0 %	41,714	49.4 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	56,227	8.9 %	44,880	8.5 %	11,347	25.3 %
0.25 μ m	4,153	0.7 %	4,336	0.8 %	(183)	(4.2)%
0.35 μ m 及以上	259,908	41.2 %	216,675	41.0 %	43,233	20.0 %
銷售收入總額	630,110	100.0 %	528,317	100.0 %	101,793	19.3 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 5,920 萬美元，同比下降 20.5%，主要由於邏輯及 CIS 產品的需求減少。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.245 億美元，同比增長 20.2%，主要得益於智能卡芯片及 MCU 產品的需求增加，部分被 CIS 產品需求減少所抵消。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 1.261 億美元，同比增長 49.4%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 5,620 萬美元，同比增長 25.3%，主要得益於 MCU 及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 420 萬美元，同比下降 4.2%。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.599 億美元，同比增長 20.0%，主要得益於 IGBT 及超級結產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈 劃分的銷售收入	二零二二年	二零二二年	二零二一年	二零二一年	同比	同比
	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	第四季度 仟美元 (未經審核)	第四季度 % (未經審核)	仟美元	%
電子消費品	390,993	62.1 %	349,050	66.1 %	41,943	12.0 %
工業及汽車	169,571	26.9 %	99,913	18.9 %	69,658	69.7 %
通訊	50,632	8.0 %	60,250	11.4 %	(9,618)	(16.0)%
計算機	18,914	3.0 %	19,104	3.6 %	(190)	(1.0)%
銷售收入總額	630,110	100.0 %	528,317	100.0 %	101,793	19.3 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.910 億美元，占銷售收入總額的 62.1%，同比增長 12.0%，主要得益於 MCU、超級結及智能卡芯片的需求增加，部分被邏輯產品的需求減少所抵消。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.696 億美元，同比增長 69.7%，主要得益於 MCU、IGBT、其他電源管理及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 5,060 萬美元，同比下降 16.0%，主要由於 CIS 產品需求減少，部分被智能卡芯片的需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,890 萬美元，同比下降 1.0%。

產能⁹及產能利用率

晶圓廠(折合 8 吋仟片晶圓)	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	65	60	65
合計產能	324	313	324
產能利用率 (200mm)	105.9%	107.5%	113.4%
產能利用率 (300mm)	99.9%	102.5%	107.7%
總體產能利用率	103.2%	105.4%	110.8%

- 本季度末月產能達 324,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 103.2%。

⁹ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	992	1,022	1,003	(2.9)%	(1.1)%

- 本季度付運晶圓 992,000 片，同比下降 2.9%，環比下降 1.1%。

經營開支分析

以千美元計	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,914	3,158	2,524	(7.7)%	15.5 %
管理費用 ¹⁰	56,665	28,708	71,087	97.4 %	(20.3)%
經營開支	59,579	31,866	73,611	87.0 %	(19.1)%

- 經營開支 5,960 萬美元，同比上升 87.0%，主要由於研發活動的政府補助減少，環比下降 19.1%，主要由於研發活動的政府補助增加。

其他收入/(損失)淨額

以千美元計	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,352	3,614	3,372	(7.2)%	(0.6)%
利息收入	10,775	3,441	7,054	213.1 %	52.8 %
匯兌收益/(損失)	22,054	21,619	(79,444)	2.0 %	(127.8)%
分佔聯營公司溢利	7,311	2,436	2,561	200.1 %	185.5 %
財務費用	(8,465)	(4,997)	(16,886)	69.4 %	(49.9)%
政府補貼	678	826	24,663	(17.9)%	(97.3)%
其他	(140)	873	855	(116.0)%	(116.4)%
其他收入/(損失)淨額	35,565	27,812	(57,825)	27.9 %	(161.5)%

- 其他收入淨額 3,560 萬美元，同比上升 27.9%，主要由於利息收入及分佔聯營公司溢利增加，部分被財務費用增加所抵消。上季度為其他損失淨額 5,780 萬美元，主要由於上季度發生較大外幣匯兌損失。

¹⁰管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二一年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	184,413	206,804	158,604	(10.8)%	16.3 %
投資活動所用現金流量淨額	(303,135)	(297,044)	(399,962)	2.1 %	(24.2)%
融資活動所得現金流量淨額	120,141	242,187	579,684	(50.4)%	(79.3)%
外匯匯率變動影響淨額	23,118	13,846	(61,748)	67.0 %	(137.4)%
現金及現金等價物變動影響淨額	24,537	165,793	276,578	(85.2)%	(91.1)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 1.844 億美元，同比下降 10.8%，環比上升 16.3%。
- 投資活動所用現金流量淨額 3.031 億美元，其中包括固定資產及無形資產投資支出 3.311 億美元，及投資一家聯營公司 400 萬美元，部分被收到政府對設備的補助 2,470 萬美元及利息收入 730 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 1.201 億美元，其中收到提取銀行借款 1.815 億美元，收到政府對財務費用的補助 1,110 萬美元，及發行股份收到 160 萬美元，部分被償還銀行貸款本金 3,980 萬美元，支付銀行借款利息 3,200 萬美元，支付上市費用 80 萬美元，支付融資保證金 80 萬美元，及租賃負債支出 70 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)
資產總額	7,052,670	6,660,372
負債總額	2,917,202	2,800,784
所有者權益總額	4,135,468	3,859,588
資產負債率 ¹¹	41.4%	42.1%

資本開支

以千美元計	二零二二年 第四季度 (未經審核)	二零二二年 第三季度 (未經審核)
華虹 8 吋	20,169	38,391
華虹無錫	310,896	390,293
合計	331,065	428,684

- 本季度資本開支 3.311 億美元，其中 3.109 億美元用於華虹無錫。

¹¹ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)
發展中物業	134,723	117,971
存貨	575,354	509,630
貿易應收款項及應收票據	291,856	240,551
預付款項、其他應收款項及其他資產	48,273	60,304
應收關聯方款項	13,006	10,764
已凍結存款及定期存款	1,042	1,022
現金及現金等價物	2,008,765	1,984,228
流動資產總額	3,073,019	2,924,470
貿易應付款項	234,293	223,704
其他應付款項及暫估費用	593,971	621,494
計息銀行借款	426,756	422,913
租賃負債	4,704	4,564
政府補助	37,714	63,274
應付關聯方款項	6,096	10,265
應付所得稅	76,176	57,730
流動負債總額	1,379,710	1,403,944
淨營運資金	1,693,309	1,520,526
速動比率	1.7x	1.7x
流動比率	2.2x	2.1x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	38	35
存貨周轉天數	125	112

- 存貨 由上季度末的 5.096 億美元上升至本季度末的 5.754 億美元，主要由於庫存增加以應對疫情風險。
- 貿易應收款項及應收票據 由上季度末的 2.406 億美元上升至本季度末的 2.919 億美元，主要由於信用期內貿易應收款增加。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產 由上季度末的 6,030 萬美元下降至本季度末的 4,830 萬美元，主要由於收到增值稅退稅。
- 其他應付款項及暫估費用 由上季度末的 6.215 億美元下降至本季度末的 5.940 億美元，主要由於應付資本性開支減少。
- 政府補助 由上季度末的 6,330 萬美元下降至本季度末的 3,770 萬美元，主要由於在本季度付確認損益。
- 應付所得稅 由上季度末的 5,770 萬美元上升至本季度末的 7,620 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支所致。
- 淨營運資金 本季度末 16.933 億美元，流動比率 2.2。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 38 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日	於十二月三十一日	於九月三十日
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)	二零二二年 (未經審核)
銷售收入	630,110	528,317	629,907
銷售成本	(389,403)	(356,800)	(395,851)
毛利	240,707	171,517	234,056
其他收入及收益	37,090	30,190	35,967
投資物業的公平值收益	394	183	-
銷售及分銷費用	(2,914)	(3,158)	(2,524)
管理費用	(56,665)	(28,708)	(71,087)
其他費用	(765)	-	(79,467)
財務費用	(8,465)	(4,997)	(16,886)
分佔聯營公司溢利	7,311	2,436	2,561
稅前溢利	216,693	167,463	102,620
所得稅開支	(30,918)	(30,213)	(37,174)
期內溢利	185,775	137,250	65,446
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	159,136	133,528	103,899
非控股權益	26,639	3,722	(38,453)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.122	0.103	0.080
攤薄	0.121	0.101	0.079
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,306,626,546	1,300,675,399	1,303,756,848
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,314,496,496	1,320,452,003	1,311,796,050

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (已審核)
銷售收入	2,475,488	1,630,754
銷售成本	(1,631,832)	(1,179,156)
毛利	843,656	451,598
其他收入及收益	70,986	60,758
投資物業的公平值收益	78	183
銷售及分銷費用	(12,464)	(10,673)
管理費用	(266,666)	(198,920)
其他費用	(111,360)	(165)
財務費用	(40,331)	(13,226)
分佔聯營公司溢利	12,171	6,765
稅前溢利	496,070	296,320
所得稅開支	(89,499)	(65,349)
年內溢利	406,571	230,971
以下各方應佔利潤：		
母公司擁有人	449,912	261,476
非控股權益	(43,341)	(30,505)
持有人應佔每股盈利		
基本	0.345	0.201
攤薄	0.342	0.198
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,303,399,389	1,300,169,098
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,313,945,277	1,320,165,735

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零二二年 (未經審核)	於九月三十日 二零二二年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二一年 (已審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	3,367,716	3,140,178	3,116,501
投資物業	169,363	165,746	184,883
使用權資產	78,425	78,359	75,331
無形資產	32,986	34,447	35,312
於聯營公司的投資	130,721	116,894	122,040
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	178,632	163,182	257,788
長期預付款項	7,742	21,939	15,573
遞延稅項資產	14,066	15,157	3,479
非流動資產總額	3,979,651	3,735,902	3,810,907
流動資產			
發展中物業	134,723	117,971	114,492
存貨	575,354	509,630	432,917
貿易應收款項及應收票據	291,856	240,551	181,042
預付款項、其他應收款項及其他資產	48,273	60,304	43,443
應收關聯方款項	13,006	10,764	6,910
已凍結存款及定期存款	1,042	1,022	2,248
現金及現金等價物	2,008,765	1,984,228	1,610,140
流動資產總額	3,073,019	2,924,470	2,391,192
流動負債			
貿易應付款項	234,293	223,704	194,385
其他應付款項及暫估費用	593,971	621,494	560,435
計息銀行借款	426,756	422,913	195,024
租賃負債	4,704	4,564	1,676
政府補助	37,714	63,274	66,837
應付關聯方款項	6,096	10,265	7,501
應付所得稅	76,176	57,730	54,543
流動負債總額	1,379,710	1,403,944	1,080,401
流動資產淨額	1,693,309	1,520,526	1,310,791
總資產減流動負債	5,672,960	5,256,428	5,121,698
非流動負債			
計息銀行借款	1,481,580	1,355,037	1,395,279
租賃負債	14,644	14,976	16,137
遞延稅項負債	41,268	26,827	25,735
非流動負債總額	1,537,492	1,396,840	1,437,151
淨資產	4,135,468	3,859,588	3,684,547
權益和負債權益			
股本	1,994,462	1,993,604	1,986,152
儲備	1,036,008	808,552	884,207
本公司擁有人應佔權益	3,030,470	2,802,156	2,870,359
非控股權益	1,104,998	1,057,432	814,188
權益總額	4,135,468	3,859,588	3,684,547

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日	於十二月三十一日	於九月三十日
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)	二零二二年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	216,693	167,463	102,620
折舊及攤銷	107,849	80,117	116,426
應佔聯營公司溢利	(7,311)	(2,436)	(2,561)
營運資金的變動及其它	(132,818)	(38,340)	(57,881)
經營活動所得現金流量淨額	184,413	206,804	158,604
投資活動所用現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(331,065)	(382,236)	(428,684)
投資聯營公司	(4,013)	-	(2,704)
處置權益工具	-	-	5,707
收到政府對物業、廠房及設備的補助	24,655	83,594	8,954
其他投資活動所得現金流量	7,288	1,598	16,765
投資活動所用現金流量淨額	(303,135)	(297,044)	(399,962)
融資活動所得現金流量：			
非控股權益資本注資	-	-	392,000
提取銀行貸款	181,470	275,021	248,768
發行股份所得收益	1,631	410	2,972
償還銀行貸款	(39,826)	(26,099)	(62,171)
償還租賃負債	(782)	(632)	(333)
已付利息	(31,861)	(6,513)	(1,552)
其他融資活動所得現金流量	9,509	-	-
融資活動所得現金流量淨額	120,141	242,187	579,684
現金及現金等價物增加淨額	1,419	151,947	338,326
外匯匯率變動影響淨額	23,118	13,846	(61,748)
期初現金及現金等價物	1,984,228	1,444,347	1,707,650
期末現金及現金等價物	2,008,765	1,610,140	1,984,228

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (已審核)
經營活動所得現金流量:		
稅前溢利	496,070	296,320
折舊及攤銷	456,860	318,016
應佔聯營公司溢利	(12,171)	(6,765)
營運資金的變動及其它	(189,894)	(89,100)
經營活動所得現金流量淨額	750,865	518,471
投資活動所用現金流量:		
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(996,182)	(938,911)
投資聯營公司	(6,717)	(7,405)
處置/(投資)權益工具	5,707	(6,290)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	38,414	83,594
其他投資活動所得現金流量	28,622	5,953
投資活動所用現金流量淨額	(930,156)	(863,059)
融資活動所得現金流量:		
非控股權益資本注資	392,000	-
提取銀行貸款	514,622	1,070,805
發行股份所得收益	6,248	7,419
償還銀行貸款	(199,670)	(47,860)
償還租賃負債	(4,144)	(3,995)
已付利息	(46,388)	(11,729)
其他融資活動所得現金流量	9,509	-
融資活動所得現金流量淨額	672,177	1,014,640
現金及現金等價物增加淨額	492,886	670,052
外匯匯率變動影響淨額	(94,261)	17,302
年初現金及現金等價物	1,610,140	922,786
年末現金及現金等價物	2,008,765	1,610,140

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二三年二月十四日